

Brusel 21. listopadu 2018
(OR. en)

14559/18
ADD 1

ENV 797
MI 870
DELECT 153

PRŮVODNÍ POZNÁMKA

Odesílatel:	Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel, za generálního tajemníka Evropské komise
Datum přijetí:	19. listopadu 2018
Příjemce:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie
Č. dok. Komise:	C(2018) 7499 final - Annex
Předmět:	PŘÍLOHA směrnice Komise v přenesené pravomoci, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití olova v pájkách pro sestavení stabilního elektrického spojení mezi polovodičovým čipem a nosičem v pouzdrech integrovaných obvodů využívajících technologii „Flip Chip“

Delegace naleznou v příloze dokument C(2018) 7499 final - Annex.

Příloha: C(2018) 7499 final - Annex



EVROPSKÁ
KOMISE

V Bruselu dne 16.11.2018
C(2018) 7499 final

ANNEX

PŘÍLOHA

směrnice Komise v přenesené pravomoci,

kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití olova v pájkách pro sestavení stabilního elektrického spojení mezi polovodičovým čipem a nosičem v pouzdrech integrovaných obvodů využívajících technologii „Flip Chip“

PŘÍLOHA

V příloze III se položka 15 nahrazuje tímto:

„15	Olovo v pájkách pro sestavení stabilního elektrického spojení mezi polovodičovým čipem a nosičem v pouzdrech integrovaných obvodů využívajících technologii „Flip Chip“	Týká se kategorií 8, 9 a 11 a platí do: – 21. července 2021 pro kategorie 8 a 9, s výjimkou diagnostických zdravotnických prostředků <i>in vitro</i> a průmyslových monitorovacích a kontrolních přístrojů, – 21. července 2023 pro diagnostické zdravotnické prostředky <i>in vitro</i> kategorie 8, – 21. července 2024 pro průmyslové monitorovací a kontrolní přístroje kategorie 9 a pro kategorii 11.
15 a)	Olovo v pájkách pro sestavení stabilního elektrického spojení mezi polovodičovým čipem a nosičem v pouzdrech integrovaných obvodů využívajících technologii „Flip Chip“, pokud je splněno alespoň jedno z těchto kritérií: – výrobní technologie 90 nm nebo více, – jediný čip s plochou 300 mm² nebo větší při použití jakékoli výrobní technologie (nm), – pouzdra s vrstvenými čipy, v nichž čip má plochu 300 mm² nebo větší anebo křemíkové vložky mají plochu 300 mm² nebo větší.	Týká se kategorií 1 až 7 a 10 a platí do 21. července 2021.“